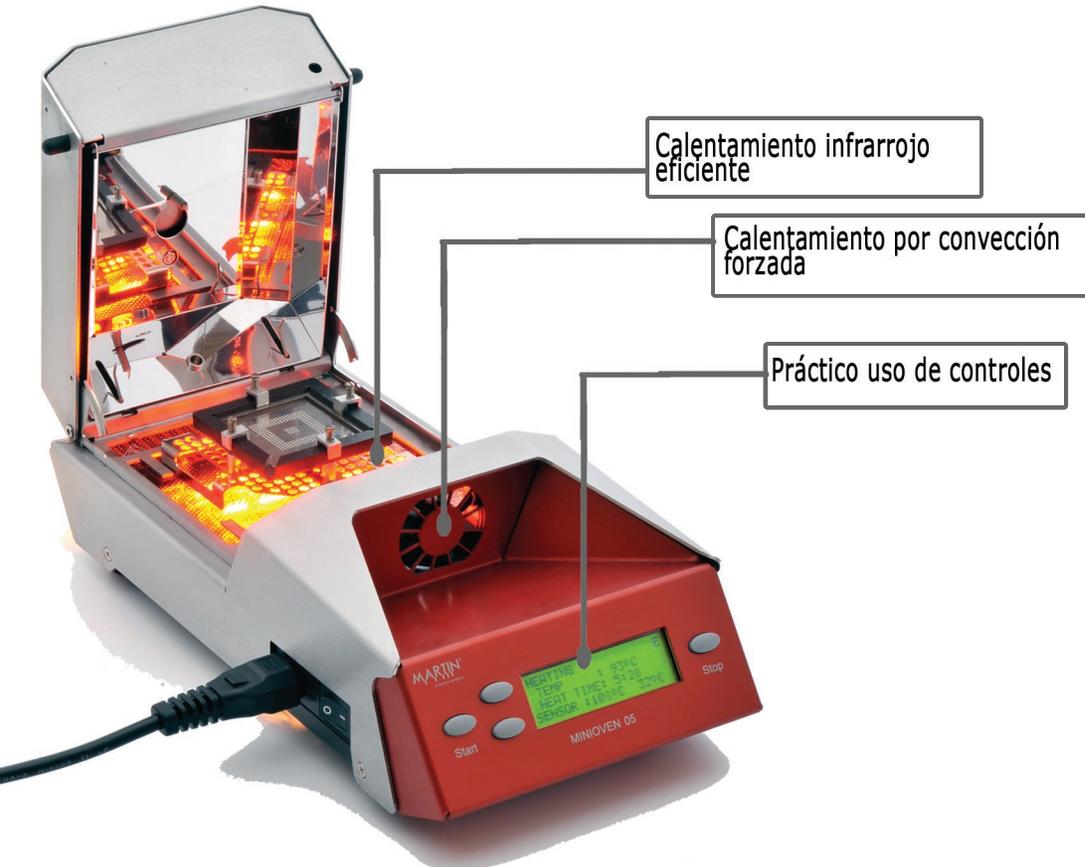
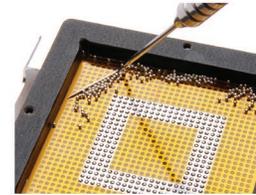


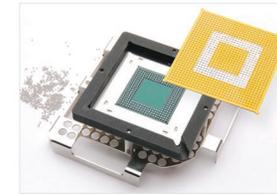
Mini Horno para Reboleo de BGA's MINIOVEN 05



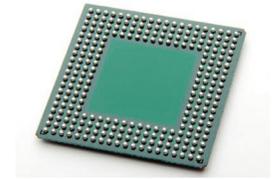
Reboleo de BGA's



Fácil distribución de esferas de soldadura en el estencil.

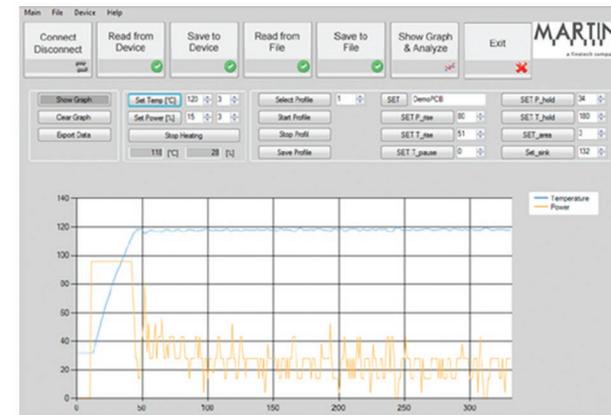


Después de correr el proceso en el horno Martin-SMT, se retira el estencil y el componente



BGA reboleado y listo para usar

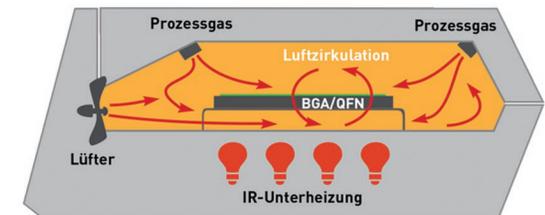
Software y gráficos



N₂

El MINIOVEN tiene la opción de trabajar con nitrógeno

El MINIOVEN emplea una combinación de convección y calentamiento infrarrojo de máxima uniformidad térmica. El uso de nitrógeno desplaza oxígeno y minimiza la oxidación, mientras promueve un ambiente ideal para la soldadura



Operación sencilla y segura | Ergonomía | Tecnología de última generación | Máxima eficiencia | Hecho en Alemania

Favor de contactarnos para: Venta | Entrenamiento | Garantía | Soporte Local en Mexico | Solicitar equipo para demostraciones